

附件

## 关于印发享受税收优惠的集成电路企业或项目、软件企业清单制定有关要求的通知

(征求意见稿)

根据《国务院关于印发新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展若干政策的通知》(国发〔2020〕8号,以下简称《若干政策》)及其配套政策有关规定,为做好国家发展改革委牵头负责的享受税收优惠的国家鼓励的集成电路企业或项目、软件企业清单(以下简称“清单”)制定工作,我们制定了工作程序,以及享受税收优惠政策的企业条件和项目标准,现通知如下:

一、本通知所称清单是指《若干政策》第(一)条提及的国家鼓励的集成电路线宽小于**28**纳米(含)、线宽小于**65**纳米(含)、线宽小于**130**纳米(含)的集成电路生产企业或项目清单;第(三)、(七)条提及的国家鼓励的重点集成电路设计企业和软件企业清单;第(六)条提及的集成电路线宽小于**65**纳米(含)的逻辑电路、存储器生产企业,线宽小于**0.25**微米(含)的特色工艺集成电路生产企业(含掩模版、**8**英寸及以上硅片生产企业),集成电路线宽小于**0.5**微米(含)的化合物集成电路生产企业和先进封装测试企业清单;第(八)条提及的集成电路重大项目清单。

二、申请列入清单的企业,原则上每年**3**月**25**日至**4**月

16日将有关申请表和必要佐证材料（电子版、纸质版）报各省、自治区、直辖市及计划单列市、新疆生产建设兵团发展改革委、工业和信息化主管部门（以下简称“地方发改和工信部门”）。

三、地方发改和工信部门根据企业条件和项目标准（附后），对企业申报的信息进行初审推荐后，报送至国家发展改革委、工业和信息化部。《若干政策》第（一）、（三）、（六）、（七）条提及的清单，由国家发展改革委、工业和信息化部会同财政部、海关总署、税务总局进行联审确认，并联合印发。《若干政策》第（八）条提及的集成电路重大项目，由国家发展改革委、工业和信息化部形成清单后，函告财政部，财政部会同海关总署、税务总局最终确定。

四、清单印发前，企业可依据财政、税务有关管理规定，先行按照企业条件和项目标准享受相关国内税收优惠政策。

五、已享受《若干政策》第（一）、（三）、（六）、（七）条税收优惠政策的企业或项目发生更名、分立、合并、重组以及主营业务重大变化等情况，应及时向地方发改和工信部门报告，并提交相关材料，由国家发展改革委、工业和信息化部会同相关部门确定发生变更情形后是否继续符合企业条件或项目标准。

六、国家发展改革委、工业和信息化部会同相关部门，根据产业发展、技术进步等情况，对符合优惠政策的企业条件或项目标准适时调整。

七、地方发改和工信部门会同财政、税务、海关对清单内的企业加强日常监管。在监管过程中，如发现企业存在以虚报信息

获得减免税资格,应及时联合核查,并联合上报国家发展改革委、工业和信息化部进行复核。复核期间涉及享受进口税收优惠政策的企业或项目,由地方发改和工信部门将暂停享受进口税收优惠政策的企业清单函告企业所在地直属海关。国家发展改革委、工业和信息化部会同相关部门复核后对确不符合企业条件和项目标准的企业或项目,函告海关总署、税务总局按相关规定处理。

八、企业对所提供材料和数据的真实性负责。申报企业应签署信用承诺书,承诺申报出现失信行为,接受有关部门按照法律、法规和国家有关规定实施的惩罚,涉及违法行为的信息记入企业信用记录,纳入全国信用信息共享平台,并在“信用中国”网站公示。

## 附件 1

# 享受税收优惠的企业条件和项目标准

一、《若干政策》第（一）条所称的国家鼓励的集成电路线宽小于 28 纳米（含）、线宽小于 65 纳米（含）、线宽小于 130 纳米（含）的集成电路生产企业或项目享受财税优惠政策条件如下：

（一）在中国境内（不包括港、澳、台地区）依法注册并具有独立法人资格的企业；

（二）符合国家布局规划和产业政策；

（三）汇算清缴年度，具有劳动合同关系或劳务派遣、聘用关系，且本科及以上学历职工人数占企业月平均职工总人数的比例不低于 30%，其中研发开发人员占企业月平均职工总数的比例不低于 20%（从事 8 英寸及以下集成电路生产的不低于 15%）；

（四）企业拥有关键核心技术和自主知识产权，并以此为基础开展经营活动，且汇算清缴年度研究开发费用总额占企业销售（营业）收入（主营业务收入与其他业务收入之和）总额的比例不低于 2%（本条及下述研究开发费用政策口径，按照财税〔2015〕119 号和《国家税务总局关于研发费用税前加计扣除归集范围有关问题的公告》（2017 年第 40 号）的规定执行）；

（五）汇算清缴年度集成电路制造销售（营业）收入占企业

收入总额的比例不低于 **60%**；

（六）具有保证相关工艺线宽产品生产的手段和能力；

（七）汇算清缴年度未发生重大安全、重大质量事故或严重环境违法行为；

（八）对于按照集成电路生产项目享受税收优惠政策的，项目主体企业应符合相应的集成电路生产企业条件，且能够对该项目单独进行会计核算、计算所得，并合理分摊期间费用。

**二、《若干政策》第（三）、（七）条所称的国家鼓励的重点集成电路设计企业享受财税优惠政策条件，除符合《若干政策》第（二）条所称国家鼓励的集成电路设计企业条件外，还应符合以下条件：**

（一）汇算清缴年度具有劳动合同关系或劳务派遣、聘用关系且具有本科及以上学历的职工人数占企业月平均职工总人数的比例不低于 **50%**，其中研究开发人员占企业月平均职工总数的比例不低于 **50%**；

（二）拥有关键核心技术，并以此为基础开展经营活动，且汇算清缴年度研究开发费用总额占企业销售（营业）收入（主营业务收入与其他业务收入之和）总额的比例不低于 **6%**；

（三）汇算清缴年度集成电路设计（含 **EDA** 工具，下同）销售（营业）收入占企业收入总额的比例不低于 **70%**，其中集成电路自主设计销售（营业）收入占企业收入总额的比例不低于 **60%**；对于集成电路设计销售（营业）收入超过 **50** 亿元的企业，汇算清缴年度集成电路设计销售（营业）收入占企业收入总额的

比例不低于**60%**，其中集成电路自主设计销售（营业）收入占企业收入总额的比例不低于**50%**；

（四）企业拥有核心关键技术和自主知识产权，企业拥有与集成电路产品设计相关的已授权发明专利、布图设计登记、软件著作权合计不少于**8**个；

除以上条件外，还应至少符合下列条件中的一项：

（一）汇算清缴年度，集成电路设计销售（营业）收入不低于**5**亿元，应纳税所得额不低于**5000**万元；对于集成电路设计销售（营业）收入不低于**50**亿元的企业，可不要求应纳税所得额，但研究开发费用总额占企业销售（营业）收入（主营业务收入与其他业务收入之和）总额的比例不低于**10%**。

（二）在国家鼓励的重点集成电路设计领域内（附件2），汇算清缴年度集成电路设计销售（营业）收入不低于**3000**万元，应纳税所得额不低于**350**万元。

三、《若干政策》第（三）、（七）条所称的国家鼓励的重点软件企业，除符合财政部联合有关部门发布的2020年第45号公告所称国家鼓励的软件企业条件外，还应至少符合下列条件中的一项，具体领域说明见附件2。

（一）专业开发系统软件、通用和支撑软件、研发设计软件、生产控制软件的企业，汇算清缴年度软件产品开发及相关信息技术服务销售（营业）收入不低于**2000**万元；

（二）专业开发新兴技术软件、信息安全软件的企业，汇算清缴年度产品开发及相关信息技术服务销售（营业）收入不低于

1 亿元；应纳税所得额不低于 500 万元；研发开发人员占企业月平均职工总数的比例不低于 30%；汇算清缴年度研究开发费用总额占企业销售（营业）收入总额的比例不低于 8%。

（三）专业开发重点领域应用软件、经营管理软件、公有云服务软件、嵌入式软件的企业，汇算清缴年度软件产品开发及相关信息技术服务销售（营业）收入不低于 5 亿元，应纳税所得额不低于 2500 万元；研发开发人员占企业月平均职工总数的比例不低于 30%；汇算清缴年度研究开发费用总额占企业销售（营业）收入总额的比例不低于 7%。

**四、《若干政策》第（六）条所称的集成电路线宽小于 65 纳米（含）的逻辑电路、存储器生产企业，以及线宽小于 0.25 微米（含）的特色工艺集成电路生产企业（含掩模板、8 英寸及以上硅片生产企业）、集成电路线宽小于 0.5 微米（含）的化合物集成电路生产企业享受财税优惠政策条件如下：**

（一）在中国境内（不包括港、澳、台地区）依法注册并具有独立法人资格的企业；

（二）符合国家布局规划和产业政策；

（三）具有保证产品生产的手段和能力；

（四）汇算清缴年度未发生重大安全、重大质量事故或严重环境违法行为。

**五、《若干政策》第（六）条所称的先进封装测试企业享受财税优惠政策条件如下：**

（一）在中国境内（不包括港、澳、台地区）依法注册并具

有独立法人资格的企业；

（二）符合国家布局规划和产业政策；

（三）汇算清缴年度企业先进封装测试（晶圆级封装、系统级封装、**2.5**维和**3**维封装）规划产能占总规划产能比例，按封装产品颗粒数或晶圆数（折合**8**英寸）计算不低于**40%**；

（四）具有保证产品生产的手段和能力；

（五）汇算清缴年度未发生重大安全、重大质量事故或严重环境违法行为。

**六、《若干政策》第（八）条所称的集成电路重大项目企业享受财税优惠政策条件如下：**

享受《若干政策》第（八）条的集成电路重大项目承建企业应符合相应的国家鼓励的集成电路企业条件和本通知第四、五条的相对应规定。除以上条件外，还应符合下列对应条件中的一项：

（一）芯片制造类重大项目，需同时满足以下条件：

1.符合国家布局规划和产业政策；

2.对于不同工艺类型芯片制造项目，需分别满足以下条件：

（1）对于工艺线宽小于**65**纳米（含）的逻辑电路、存储器项目，固定资产投资总额需超过**100**亿元，规划月产能超过**1**万片（折合**12**英寸）。

（2）对于工艺线宽小于**0.25**微米（含）的模拟、数模混合、高压、射频、功率、光电集成、图像传感、微机电系统、绝缘体上硅工艺等硅材料特色芯片制造项目，固定资产投资总额超过**10**亿元，规划月产能超过**1**万片（折合**8**英寸）。

(3) 对于工艺线宽小于 0.5 微米的基于化合物集成电路制造项目，固定资产投资额超过 10 亿元，规划月产能超过 1 万片（折合 6 英寸）。

(二) 先进封装测试类重大项目，需同时满足以下条件：

1. 符合国家布局规划和产业政策；
2. 固定资产投资额超过 10 亿元；
3. 封装规划年产能超过 10 亿颗芯片或 50 万片晶圆（折合 8 英寸）。

## 附件 2

# 重点集成电路设计领域和重点软件领域

### 一、重点集成电路设计领域

如业务范围涉及多个领域，仅选择其中一个领域进行申请。选择领域的销售（营业）收入占本企业集成电路设计销售（营业）收入的比例不低于 **50%**。

- （一）高性能处理器和 **FPGA** 芯片；
- （二）存储芯片；
- （三）智能传感器；
- （四）工业、通信、汽车和安全芯片；
- （五）**EDA**、**IP** 和设计服务。

### 二、重点软件领域

如业务范围涉及多个领域，仅选择其中一个领域进行申请。选择领域的软件开发及相关信息技术服务销售（营业）收入占本企业软件产品开发及相关信息技术服务销售（营业）收入的比例不低于 **50%**（其中相关信息技术服务是指实现选择领域软件产品功能直接相关的咨询设计、软件运维、数据服务）。企业拥有所选择领域相应的发明专利不少于 **2** 项，相应领域软件产品登记证书不少于 **2** 项（均应具备对应的测试报告）。

- （一）系统软件：操作系统、数据库管理系统、固件（**BIOS**）。
- （二）通用和支撑软件：开发支撑软件、中间件、通用办公

软件、少数民族语言文字编辑处理软件。

(三) 研发设计软件：虚拟仿真系统、计算机辅助设计 (CAD)、计算机辅助工程 (CAE)、计算机辅助制造 (CAM)、计算机辅助工艺规划 (CAPP)、建筑信息模型 (BIM)、产品数据管理 (PDM) 软件。

(四) 生产控制软件：工业控制系统、制造执行系统 (MES)、制造运行管理 (MOM)、调度优化系统 (ORION)、先进控制系统 (APC)、安全仪表系统 (SIS)、可编程控制器 (PLC)。

(五) 新兴技术软件：分布式计算、数据分析挖掘、可视化、数据采集清洗等大数据软件，人机交互、通用算法软件、基础算法库、工具链、机器学习和深度学习框架等人工智能软件，信息系统运行维护软件，超级计算软件，区块链软件，工业互联网平台软件，云管理软件，虚拟化软件。

(六) 信息安全软件：信息系统安全、网络安全、密码算法、数据安全、安全测试等方面的软件。

(七) 重点领域应用软件：面向党政机关、国防、能源、交通、物流、通信、广电、医疗、建筑、制造业、应急、社保、农业、水利、教育文化、金融财税、知识产权、检验检测、科学研究、公共安全、节能环保、自然资源、城市管理、地理信息等领域的专业应用软件。

(八) 经营管理软件：企业资源计划 (ERP)、供应链管理 (SCM)、客户关系管理 (CRM)、人力资源管理 (HEM)、企业资产管理 (EAM)、产品生命周期管理 (PLM)、运维综合保障管

理（MRO）软件及相关云服务。

（九）公有云服务软件：大型公有云 IaaS、PaaS 服务软件。

（十）嵌入式软件（软件收入比例不低于 50%）：通信设备、汽车电子、交通监控设备、电子测量仪器、装备自动控制、电子医疗器械、计算机应用产品、终端设备等嵌入式软件及嵌入式软件开发环境相关软件。

（以上部分软件名词涵盖范围可参考国家标准 GB/T 36475 软件产品分类）

### 附件 3

## 享受企业税收优惠政策的集成电路企业和软件企业提交材料明细表

企业类型	材料清单（复印件须加盖企业公章）
享受《若干政策》第（一）条的集成电路生产企业	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.企业法人营业执照副本、企业取得的其他相关资质证书等；（可提供相应查询网址）</li> <li>2.项目备案文件（备案表）；（可提供相应查询网址）</li> <li>3.企业职工人数、学历结构、研究开发人员情况及其占职工总数的比例说明，企业研究开发人员名单，以及上年度最后一个月的企业职工社会保险缴纳证明（包括劳务派遣人员代缴社保付款凭证）等相关证明材料；</li> <li>4.企业主要工艺、产品列表（名称/规格）；</li> <li>5.企业拥有与主营产品相关的发明专利等证明材料；</li> <li>6.经具有资质的中介机构鉴证的汇算清缴年度企业会计报告（包括会计报表、会计报表附注和财务情况说明书等），以及集成电路代工制造销售（营业）收入、自有集成电路产品制造销售（营业）收入、研究开发费用等情况表；</li> <li>7.与主要客户签订的一至两份代表性销售合同复印件；</li> <li>8.企业具有保证产品生产的手段和能力的证明材料（包括采购设备清单等）；</li> <li>9.省级发展改革委要求出具的其他材料。</li> </ol>
享受《若干政策》第（三）、（七）条的重点集成电路设计企业	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.企业法人营业执照副本、企业取得的其他相关资质证书等；（可提供相应查询网址）</li> <li>2.企业职工人数、学历结构、研究开发人员情况及其占职工总数的比例说明，企业研究开发人员名单，以及上年度最后一个月的企业职工社会保险缴纳证明（包括劳务派遣人员代缴社保付款凭证）等相关证明材料；</li> <li>3.企业开发销售的主要产品和服务列表（名称/重点领域/对应销售（营业）收入规模）；</li> <li>4.企业拥有与主营产品相关的不少于 8 项的已授权发明专利、布图设计登记、软件著作权的证明材料；</li> <li>5.经具有资质的中介机构鉴证的汇算清缴年度企业会计报告（包括会计报表、会计报表附注和财务情况说明书等），以及集成电路设计销售（营业）收入、集成电路自主设计销售（营业）收入、研究开发费用等情况表；</li> <li>6.第三方检测机构提供的集成电路产品测试报告或用户报告，以及与主要客户签订的一至两份代表性销售合同复印件；</li> <li>7.企业具有与集成电路设计相适应的软硬件设施等开发环境的证明材料；</li> <li>8.省级发展改革委要求出具的其他材料。</li> </ol>

企业类型	材料清单（复印件须加盖企业公章）
享受《若干政策》第（三）、（七）的重点软件企业	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.企业法人营业执照副本、企业取得的其他相关资质证书等；（可提供相应查询网址）</li> <li>2.企业职工人数、学历结构、研究开发人员情况及其占职工总数的比例说明，企业研究开发人员名单，以及上年度最后一个月的企业职工社会保险缴纳证明（包括劳务派遣人员代缴社保付款凭证）等相关证明材料；</li> <li>3.企业开发销售的主要软件产品列表（名称/重点领域/对应销售（营业）收入规模）；</li> <li>4.企业具有所申报领域相应的已授权发明专利不少于<b>2</b>项，相应领域软件产品登记证书不少于<b>2</b>项（均应具备对应的测试报告）的证明材料；</li> <li>5.经具有资质的中介机构鉴证的汇算清缴年度企业会计报告（包括会计报表、会计报表附注和财务情况说明书等），以及软件产品开发销售和相关信息技术服务（营业）收入、软件产品自主开发销售（营业）收入、研究开发费用、境内研究开发费用等情况表；</li> <li>6.与主要客户签订的一至两份代表性销售合同复印件；</li> <li>7.企业具有与软件开发相适应软硬件设施等开发环境（如合法的开发工具等）的证明材料；</li> <li>8.省级发展改革委要求出具的其他材料。</li> </ol>
享受《若干政策》第（六）条的集成电路生产企业	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.企业法人营业执照副本、企业取得的其他相关资质证书等；（可提供相应查询网址）</li> <li>2.项目备案文件（备案表）（可提供相应查询网址）；</li> <li>3.企业具有保证产品生产的手段和能力的证明材料（包括采购设备清单等），先进封装、测试企业需提供按封装产品颗粒数或晶圆数（折合<b>8</b>英寸）计算，先进封装测试（晶圆级封装、系统级封装、<b>2.5</b>维和<b>3</b>维封装）规划产能占总规划产能比例不低于<b>40%</b>的证明材料；</li> <li>4.省级发展改革委要求出具的其他材料。</li> </ol>
享受《若干政策》第（八）条的集成电路重大项目	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.项目企业对应类别集成电路企业条件材料清单；</li> <li>2.固定资产投资额相关证明材料；</li> <li>3.省级发展改革委要求出具的其他材料</li> </ol>